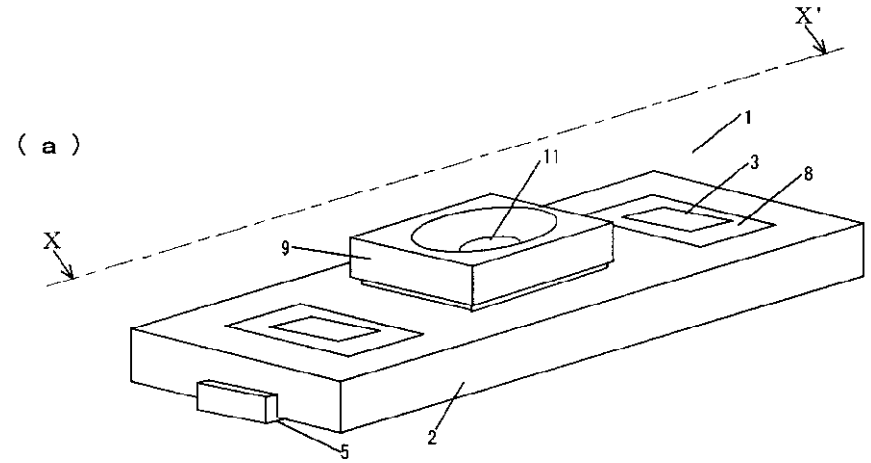
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成18年11月24日(2006.11.24)

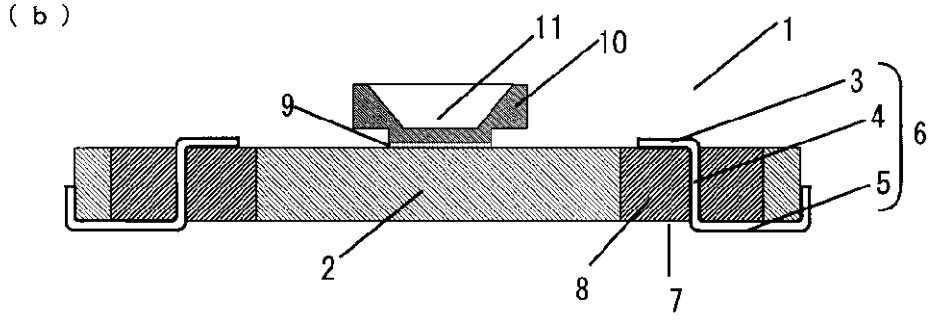
【公開番号】特開2006-4987(P2006-4987A)
【公開日】平成18年1月5日(2006.1.5)
【年通号数】公開・登録公報2006-001
【出願番号】特願2004-176833(P2004-176833)
【国際特許分類】
　Ｈ０１Ｌ　33/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　33/00　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月11日(2006.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】

１　光半導体素子用パッケージ	７　貫通孔
２　セラミック基体	８　封着ガラス
３　素子接続端子	９　素子搭載部材
４　リード部	１０　ろう材
５　実装端子	１１　素子搭載凹部
６　リード端子	

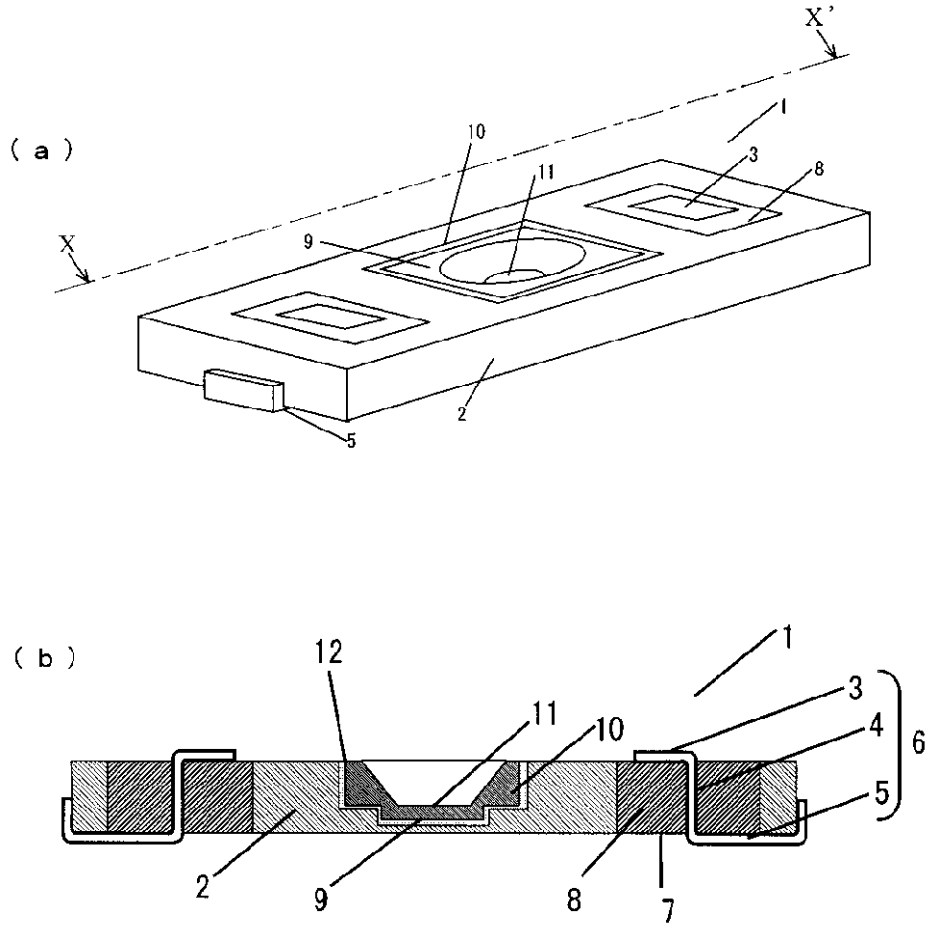




【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図２】

１２　開口部



【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図３】

